

※本リリースは 2026 年 3 月 17 日に発表されたリリースを訳したものです

## タワーセミコンダクター、第 3 世代 LDMOS 技術により BCD 性能のリーダーシップを強化し、「AI パワーウォール」に対応

AI プロセッサ向け電源供給および高電流アプリケーションに向けた最新の電源管理プラットフォームの進展を、APEC 2026 にて発表

イスラエル、ミグダルハエメク – 2026 年 3 月 17 日 – 高付加価値アナログ半導体ソリューションのリーディングファウンドリである[タワーセミコンダクター](#)（NASDAQ/TASE: TSEM）は本日、最新世代の BCD 技術を発表しました。本技術は、同社の第 3 世代電源管理プラットフォームであり、キー技術として高電流アプリケーション向けに業界最高クラスの LDMOS を提供します。新プラットフォームは、AI データセンターにおいて急増する電力需要に加え、先進的なモバイル PMIC および充電アプリケーションにも対応するよう設計されています。

タワーは、2026 年 3 月 23 日～25 日に米国テキサス州サンアントニオの Henry B. Gonzalez Convention Center で開催される APEC 2026 に出展し（ブース番号：#1455）、本技術を紹介します。

AI インフラにおける消費電力はかつてない規模で増加しています。プロセッサ性能の向上に伴い、電力供給は重大なボトルネックとなっており、「AI パワーウォール」として広く認識されています。タワーの第 3 世代 LDMOS 技術は、この課題に対し、高効率な電力供給を可能にし、発熱の低減とシステム全体の性能向上に寄与します。また、大電力トランジスタを多く含む電源管理 IC において、ダイサイズの大幅な削減も実現します。

本技術は、モノリシック・スマートパワーステージおよび DrMOS アプリケーションを主な対象としており、同市場は現在約 25 億ドル規模、2031 年には 47 億ドル以上へと成長すると予測されています（Mordor Intelligence 調べ）。今回提供される技術には、AI プロセッサ向けの横方向給電および縦方向給電の双方に対応するために最適化されたパワーデバイス群が含まれ、スイッチング損失および導通損失の極小化を実現します。

タワーは、AI データセンターにおけるシリコンフォトニクス分野での実績と、先進的な電源管理技術を融合することで、光インターコネクに加え、AI プロセッサ向けの高効率電源供給分野へとその役割を拡大しています。

## **APEC 2026 開催概要**

会期中、既存および新規のお客様との商談に対応いたします。

日程：2026年3月23日～25日

会場：Henry B. Gonzalez Convention Center（米国テキサス州サンアントニオ）

ブース：#1455

## **講演概要**

講演タイトル：Towerの電源管理技術：最高のシステム効率と高集積化の実現

講演者：Dr. Mete Erturk（パワーマネジメント事業部 副ゼネラルマネージャー）

日時：2026年3月24日 15:45～16:15

会場：Expo Theater 3

タワーの先進的な電源管理プラットフォームの詳細については、[こちら](#)をご覧ください。

## **タワーセミコンダクターについて**

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーとして、コンシューマー、産業機械、車載、モバイル、インフラ、医療、航空宇宙・防衛など幅広い成長市場のお客様に向けて集積回路(IC)の技術開発・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先進的かつ革新的なアナログテクノロジーの提供を通じ、世界に新しいサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiPho、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-imaging sensor、ディスプレイ、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスの設計支援環境を整備し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。マルチファブによる供給体制と拡張された生産能力を提供するため、タワーセミコンダクターは現在、イスラエルに 1 拠点(200mm)、米国に 2 拠点(200mm)、また、日本ではタワーセミコンダクターが 51%の株式を保有する TPSCo に 2 拠点(200mm 及び 300mm)の生産拠点を有し、イタリアのアグラテでは 300mm 工場を ST Microelectronics と共有しています。詳細は [www.towersemi.com](http://www.towersemi.com) をご覧ください。

## **Safe Harbor Regarding Forward-Looking Statements**

This press release includes forward-looking statements, which are subject to risks and uncertainties. Actual results may vary from those projected or implied by such forward-looking statements. A complete discussion of risks and uncertainties that may affect the accuracy of forward-looking statements included in this press release or which may otherwise affect Tower's business is included under the heading "Risk Factors" in Tower's most recent filings on Forms 20-F, F-3, F-4 and 6-K, as were filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") and the Israel Securities Authority. Tower does not intend to update, and expressly disclaim any obligation to update, the information contained in this release.

**Tower Semiconductor Company Contact:** Orit Shahar | +972-74-7377440 | [oritsha@towersemi.com](mailto:oritsha@towersemi.com)

**Tower Semiconductor Investor Relations Contact:** Liat Avraham | +972-4-6506154 | [liatavra@towersemi.com](mailto:liatavra@towersemi.com)